

音と映像と通信のプロフェッショナル展 Inter BEE 2023 に日本サムスンと共同出展

日本サムスン株式会社(本社: 東京都港区)と、その販売特約店である ITG マーケティング株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 福田 茂男)は、2023年11月15日(水)~17日(金)に幕張メッセにて開催される「音と映像と通信のプロフェッショナル展 Inter BEE 2023」(ホール2 小間番号 2512)に出展いたします。



日本サムスンのブースでは、「映像制作のワークフローを快適にする Samsung SSD」をコンセプトに、速さと信頼性を融合したストレージソリューションをご紹介します。

映像機器およびパソコン機器各社との協力により、高性能で大容量の SSD やメモリカードを組み合わせることで、高速データ転送による制作ワークフローの時間短縮を実現し、大切な映像コンテンツの安全かつスムーズな運用をご提案いたします。

■主な展示内容

<映像関連で用途の広がりを見せるポータブル SSD>

近年、USB-C®接続の外付け SSD への直接動画収録に対応するデジタル一眼カメラが増えており、展示ブースでは各社のカメラと連続書き込み性能に優れた「Portable SSD T9」および「Portable SSD T7 Shield」などを実機展示いたします。新たな動きとして、外付け SSD に直接動画収録できるスマートフォンも登場しており、大容量かつコストの高い記録メディアとして SSD の用途が広がっています。

Portable SSD T9

インターフェース
USB 3.2 Gen 2x2 対応
最大読み出し / 書き込み速度
2,000 MB/s / 2,000 MB/s

4TB 2TB 1TB



Portable SSD T7 Shield

インターフェース
USB 3.2 Gen 2 対応
最大読み出し / 書き込み速度
1,050 MB/s / 1,000 MB/s

4TB 2TB 1TB



<撮影データのオフロード時間を短縮>

大容量の撮影データを高速かつ効率的にオフロードするには、高速なストレージを選択するだけでなく、プロセス全体のボトルネックを解消する必要があります。展示ブースでは、お客様の環境に最適なオフロードプロセスとストレージをご提案いたします。

最大読み出し速度 200MB/s メモリーカード



大容量 SSD 搭載 外付け RAID ストレージ



インターフェース
Thunderbolt™ 3
/ USB 3.2 Gen 2 対応

最大容量
約 46TB
(RAID 0)

外形寸法
123 x 165.61 x 232mm
※ハンドル部含まず

重量
約 4kg
※SSD を含む

<4K8K マルチストリーム編集ワークステーション>

最大 32TB の超高速 NVMe™ SSD RAID システムで約 28GB/s のハイパフォーマンスを実現する、Intel Xeon CPU 搭載のモンスター級ワークステーションを実機展示いたします。4K8K のマルチストリーム編集を快適にします。

TSUKUMO
QX9J-M231/XB
特別カスタマイズモデル



HighPoint RAIDコントローラ
SSD7540



NVMe™ SSD
990 PRO

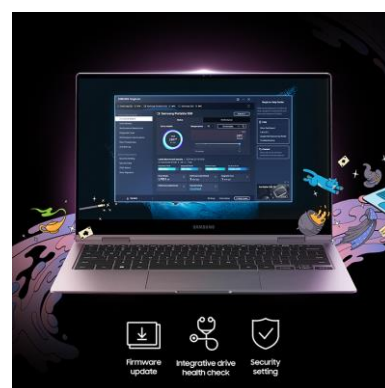


<セキュリティ体験キャンペーンを実施>

映像データのバックアップに活躍する外付け SSD ですが、Samsung では高速性能だけでなく、保存されたデータに対するセキュリティも重要だと考えており、すべての外付け SSD 製品においてパスワードによるデータ保護機能を搭載しています。

展示ブースでは「セキュリティ体験コーナー」を設け、Windows、macOS、Android のマルチ OS で、外付け SSD のセキュリティ機能を体験いただけます。体験いただいた方には素敵なプレゼントが当たるくじ引きにご参加いただけます。

※くじ引きのご参加は期間中お一人様 1 回までとさせていただきます。



■ 共同出展および機材協力会社(順不同)

<共同出展>

株式会社聖仁商事(Areca 日本正規代理店) <https://www.seijinshoji.co.jp/>
株式会社ヤマダホールディングス(TSUKUMO) <https://shop.tsukumo.co.jp/>

<機材協力>

麻布リース株式会社 <https://azabu-l.com/>
イメージビジョン株式会社(FALCAM 代理店) <http://www.imagevision.jp/index.html>

有限会社オリオスペック <https://www.oliospec.com/>
オンサイトスタンダード株式会社 (HighPoint 取扱い代理店) <http://www.onsitestandard.co.jp/>
株式会社シグマ <https://www.sigma-global.com/jp/>
株式会社セキド (DJI 正規代理店) <https://sekidocorp.com/>
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 <https://panasonic.jp/dc/>
株式会社 PANDASTUDIO.TV <https://rental.pandastudio.tv/>
富士フイルム株式会社 <https://www.fujifilm.com/jp/ja>
ブラックマジックデザイン株式会社 <https://www.blackmagicdesign.com/jp>
株式会社アイ・オー・データ機器 <https://www.iodata.jp/>

■Inter BEE 2023 開催概要および出展小間番号

会期: <幕張メッセ会場>
2023年11月15日(水)～17日(金) 10:00～17:30(最終日のみ 17:00 まで)
<オンライン>
2023年11月6日(月)～12月15日(金)

会場: 幕張メッセ / オンライン

入場: 無料(全来場者登録入場制)

公式サイト: <https://www.inter-bee.com/ja/> (日本語サイト)

小間番号: ホール 2 / 2512

・本プレスリリースに掲載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。リリース本文中では、必ずしも商標表示(「™」や「®」)を付記していません。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Mac および macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

Android は、Google LLC の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

NVM Express の図形標章、NVM Express は NVM Express, Inc.の登録商標です。

USB Type-C、USB-C は、USB Implementers Forum の登録商標です。

・本プレスリリースに掲載されている内容、サービスならびに製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。